

证券代码：300554

证券简称：三超新材

南京三超新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2023年05月11日 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 邹余耀 董事、副总经理 狄峰 董事、董事会秘书 吉国胜 董事、财务总监 姬昆 独立董事 余刚 保荐代表人 傅鹏翔 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1.请问贵公司目前月产量几何？钨丝线和金刚线最细线径是多少？</p> <p>答:您好！从一季度情况看，受光伏行业波动等因素影响，今年1-2月份下游客户开工不足，影响了硅切片线的订单，从3月份开始订单量有所上升，一季度细线和粗线产量总体较去年同期有明显上升。公司目前在批量销售的钨丝线最细是28线，碳钢线最细线是32线，但钨丝线受制于原材料供应不足的情况，销量相对较小。谢谢！</p> <p>2.请问邹董事长，为何在产能相较同业其他公司小的情况下，存货却更高？公司大量储备原材料的出发点是什么？</p> <p>答：您好，谢谢您的提问：1、硅切片线扩产：①公司2022年度开始加</p> |

大力度持续扩张硅切片线产能，生产过程中设备须铺底大量原材料；
②随新增产能逐渐释放，为满足生产，备料持续上升；2、硅切片线的核心原材料价格变动：镍、金刚石微粉采购价格，在过去3年整体显上升趋势；3、和同业其他公司产品结构可能不同：公司粗线（磁材线、蓝宝石线、光伏线）占营收比一直较高，导致存货结构与其他公司可能不同。4、公司规模效益可能小于同业其他公司：故公司正在积极扩产硅切片线产能，以提升营业额，摊薄各项成本费用，提升周转。

3.狄总，可否具体介绍一下年报中提到的mes系统对公司管理效率的提升，本系统是自主研发还是外采？这个系统在行业中的应用情况？

答：您好！MES系统从金刚石砂轮原料混料开始，一直至成品入库的整个生产全过程中，对材料的领用数量及核对、加工过程的控制、员工效率的反应、产品的追溯都起到很好的管理作用，提高了管理效率。MES系统是外采的。这个系统目前有部分同行已经有相应的应用。谢谢！

4.请问吉总今年的粗线市场竞争格局是否还在加剧，粗线价格是否有企稳迹象？

答：您好！随着金刚线使用行业范围的不断拓展，市场上粗线的需求量有所增加，竞争格局情况相对不大，粗线价格下降幅度很小；同时产品的迭代对价格稳定也起到了一定的作用。谢谢！

5.邹董事长好，请问公司之前研发出的划片刀的推广情况如何？以及在研的激光切割保护液（SPL-1）、硬刀划片保护液（SDH）和钻石研磨液（SiCP）进展如何？

答：你好，公司划片刀产品推广总体进展顺利，目前产品性能、品质提升较为明显，部分规格产品已可替代进口或国内竞品，并显示出较好的竞争力。激光切割保护液、硬刀划片保护液已有少量销售，钻石研磨液仍在开发中。谢谢您的提问！

6.邹总好！想请问公司整体对2022年度半导体业务业绩的整体自我评价如何？2023年这块业务的目标及规划是怎样的？现在有无正在对接的大客户？谢谢！

答：你好，公司对2022年度半导体业务的进展整体评价是比较满意

的，我们设立了三晶半导体这个独立的子公司平台，并推行了员工持股，起到了较好的激励效果，目前三晶团队的凝聚力和拼劲都是比较足的，各产品线业务都取得了较好的进展，CMP-DISK、硬刀在投产第一年均取得了较大突破，软刀销售规模实现了稳步快速增长。2023年半导体产品业务将力争实现销售规模上一个台阶，要进一步提升产品技术品质水平，重点开拓行业标杆客户，打造行业口碑。目前正在对接的大客户有中环领先、中欣晶圆、绍兴中芯、江阴长电、华天、甬矽等。

7.领导好。公司半导体业务比较宽泛，涉及的产品比较多。能不能就南京三芯的硅棒磨倒一体机、硅片倒角机、减薄机的研发、销售情况、市场规模、竞争格局等，做一个详细的介绍。非常感谢。

答：您好！子公司南京三芯的硅棒磨倒一体机预计在今年上半年推出样机，硅片倒角机和减薄机尚在研发中。目前除硅棒磨倒一体机外，半导体用硅片倒角机和减薄机设备绝大多数来自国外进口，国产替代前景广阔。谢谢！

8.记得去年底公司计划大规模扩产金刚线生产线，不知进展情况怎样？

答：您好！公司子公司江苏三泓金刚线扩产项目一期，目前在进行设备调试和生产准备工作。谢谢您的关注！

9.请问董事长：一季报毛利率相较于去年改变不大，预计何时可以看到毛利率拐点，一期新产能将在何时投放？

答：毛利率：公司23年1季度毛利率较22年一季度及22年全年均有所上升；随着公司先进产能陆续释放，产品成本可能进一步下降；金湖一期项目的设备目前正在安装调试，生产准备当中。

10.请问公司在国内市场占有率多少排名如何，目前主要经营风险是哪些，如何化解，谢谢！

答：您好！公司的各个产品板块均未见权威机构的市占率排名。目前公司的经营风险主要来自于产能硅切片线，虽然有下游光伏产业同步扩张，和切片线细线化导致用线量的增加，但该行业产能扩张较快，且未来几年仍可能存在大规模产能扩张计划，将来硅切片线产能将大幅增加，不排除出现产能过剩，导致竞争加剧，产品价格及毛利率有

可能大幅下降。为化解风险，公司将持续保持较高的研发投入水平，坚持以技术进步驱动企业发展。金刚线方面，公司将重点围绕提高生产效率、提高上砂率、降低物料损耗、提高智能制造水平，确保生产稳定性和质量稳定性等方面进行研发，持续改进存量产品和开发新产品，从而提升核心竞争力与产品品质；金刚石砂轮方面，继续推进电镀软刀、电镀硬刀、CMP-DISK 等半导体用精密砂轮，以及精密刀具加工用砂轮、陶瓷结合剂砂轮等重点新产品开发，力争尽快实现该等产品的技术突破和大批量销售；半导体制造设备方面，加快硅棒磨倒一体机的推出和市场推广，加快硅片倒角机和减薄机的研发进度，提升公司的赢利能力。谢谢！

11.请问邹总，公司半导体业务布局有好几年了，涉及的产品也多，并且都即将放量收获期。请问邹总，有没有可能在今、明两年内半导体业务再造一个三超？实现亿元以上的销售？谢谢。

答：你好，半导体产品确实是公司长期布局投入的方向，目前也逐步开始取得了明显的进展，半导体业务实现销售过亿，再造一个三超当然也是我们的奋斗目标，总体而言，公司对于相关业务的发展前景是比较有信心的。

12.邹总好。金湖一期有可能在今年五月份正式投产吗？现在金刚石细线的盈利有没有下滑？还能够实现每公里6-8元的净利吗？谢谢

答：金湖一期项目的设备目前正在安装调试，生产准备当中；随着先进产能的逐渐释放，规模化效益有所提升，硅切片线利润率较去年同期有所上升。

13.邹总好。半导体是典型的技术密集型产业，门槛很高。三超公司也是跨行业进入半导体业务的，市场也在传公司是为了“炒概念”进入半导体的。能不能介绍一下公司半导体业务的项目负责人，以及他们的半导体履历、研发成果、主要发明专利等，打消投资者心头的疑惑。谢谢。

答：你好，公司的半导体业务产品主要仍属于金刚石工具类产品，只是应用领域和应用的加工精度要求有差异，因此，并不属于跨行业，公司在相关产品方面已投入研发多年，而且该类产品的技术、工艺与公司一直从事的传统金刚石工具类产品均有一定相通之处。公司目前

| | |
|------------------------|---|
| | <p>半导体业务的技术团队既有来自于内部培养的精通金刚石工具研制的技术人员、也有外部引进的精通相关产品开发的技术专家以及具有半导体行业从业经历和应用经验的技术人员。谢谢!</p> <p>14.邹总好。据了解，日本DISCO公司是我们的标杆，DISCO公司是相关领域的全球老大。三超公司与DISCO比较，除了规模小以外，还有哪些差距？我们还需要在哪些方面弥补和努力？谢谢。</p> <p>答：你好，DISCO公司的确是行业内的标杆企业，不得不承认，我们与DISCO公司相比，目前还是存在较大的差距的，除了规模之外，DISCO公司的设备与耗材业务是相互促进的，并有长达数十年的产品研发及应用积累，在产品研发基础和应用能力方面我们与其还有较大差距，在精密制造及产品品质稳定性方面也存在差距。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2023年05月11日</p> |